

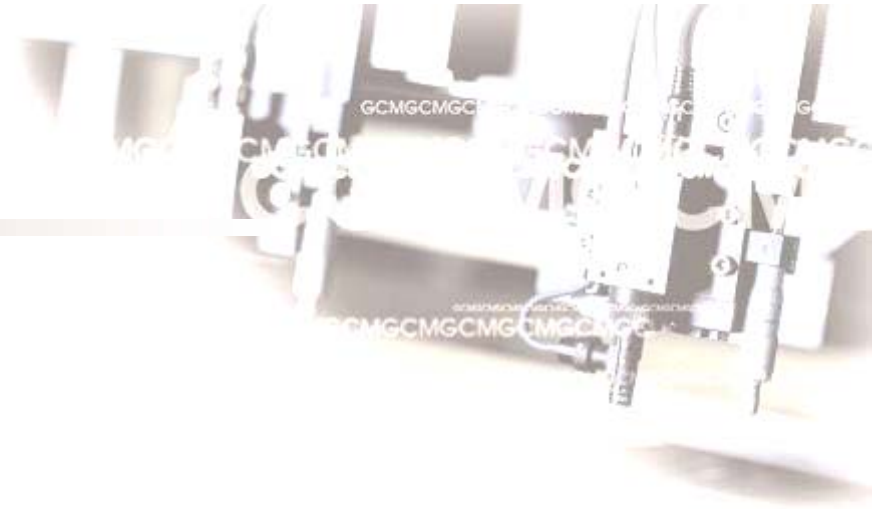
**JASDAQ**  
Listed Company 6323

# 2008年2月期決算説明会資料



2008年4月21日  
RORZE CORPORATION

**RORZE**



# 2008年2月期 決算概要



# 2008年2月期 連結損益計算書

(百万円)

	2007年2月期 実績	2008年2月期 実績	前期比	増減理由等
売上高	13,404	13,569	101.2%	【増加要因】 ・前期同様、国内及び台湾・韓国を中心としてウエハ ソータ及びEFEM受注が好調に推移 ・韓国における液晶関連装置の大口売上
売上総利益	3,810	3,987	104.6%	【増加要因】 ・売上増収効果(当社) ・台湾子会社の現地生産比率増加に伴うコストダウン 【減少要因】 ・液晶関連装置の新規開発・製造に伴うコスト増加 ・米国子会社の減収
販管費	2,097	2,157	102.8%	【増加要因】 ・売上増加に伴う各種経費増加 ・営業面の強化費用 等 【減少要因】 ・効率化推進によるコスト削減
営業利益	1,712	1,829	106.8%	
経常利益	1,692	1,806	106.7%	(営業外損益の増減につきましては、決算短信をご参照下さい)
当期純利益	1,073	1,298	120.9%	(特別損益の増減につきましては、決算短信をご参照下さい)

# 2008年2月期 連結貸借対照表

(百万円)

	2007年2月期 実績	2008年2月期 実績	増減	増減理由等
流動資産	11,898	12,964	1,066	・現金及び預金増加 +533 ・その他増加 +516
固定資産等	8,853	8,352	△500	・主に韓国子会社の旧工場売却等 による建物及び構築物減少 △328 ・同様の理由による土地減少 △145 ・韓国子会社の研究開発施設への 投資等による建設仮勘定増加 +187
資産合計	20,751	21,317	565	
流動負債	7,990	8,053	63	・支払手形及び買掛金減少 △718 ・短期借入金増加 +241 ・その他増加 +352
固定負債	3,380	2,945	△435	・長期借入金減少 △418
負債合計	11,370	10,999	△371	
株主資本	7,215	8,425	1,210	・利益剰余金増加 +1,210
評価・換算差額等	486	248	△238	・評価・換算差額等減少 △238
少数株主持分	1,678	1,643	△35	
純資産合計	9,380	10,318	937	
負債純資産合計	20,751	21,317	565	

# 2008年2月期 連結キャッシュ・フロー

(百万円)

	2007年2月期 実績	2008年2月期 実績	増 減
営業活動による キャッシュ・フロー	550	1,329	778
投資活動による キャッシュ・フロー	△393	△476	△83
財務活動による キャッシュ・フロー	△935	△263	672
現金及び現金同等物 に係る換算差額	96	△56	△152
現金及び現金同等物 の減少額	△682	533	1,215
現金及び現金同等物 の期首残高	2,235	1,553	△682
現金及び現金同等物 の期末残高	1,553	2,086	533

# 2008年2月期 単体損益計算書

(百万円)

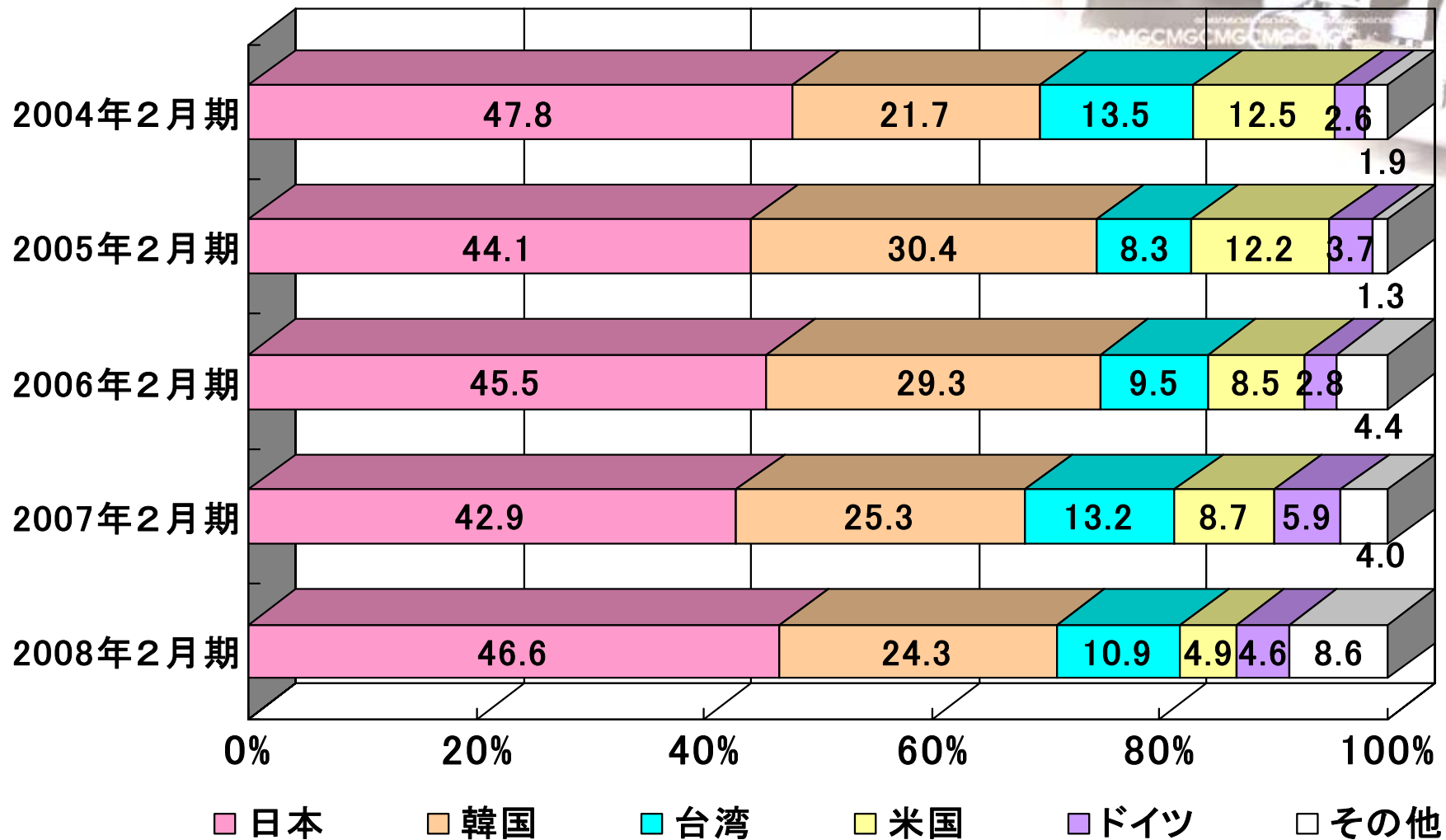
	2007年2月期 実績	2008年2月期 実績	前期比	増減理由等
売上高	9,138	9,716	106.3%	【増加要因】 ・半導体の微細化を行うデバイスメーカー 及びシリコンウエハメーカー向けのウエハ ソータ・EFEMの受注増加
売上総利益	2,023	2,353	116.3%	【増加要因】 ・売上増収効果 ・ベトナム生産子会社からの仕入価格低減
販管費	1,064	1,076	101.1%	【増加要因】 ・売上増加に伴う販売促進費等の各種経費 増加 【減少要因】 ・効率化推進によるコスト削減
営業利益	958	1,277	133.2%	
経常利益	965	1,243	128.8%	(営業外損益の増減につきましては、 決算短信をご参照下さい)
当期純利益	567	726	127.9%	(特別損益の増減につきましては、 決算短信をご参照下さい)

# 2008年2月期 単体貸借対照表

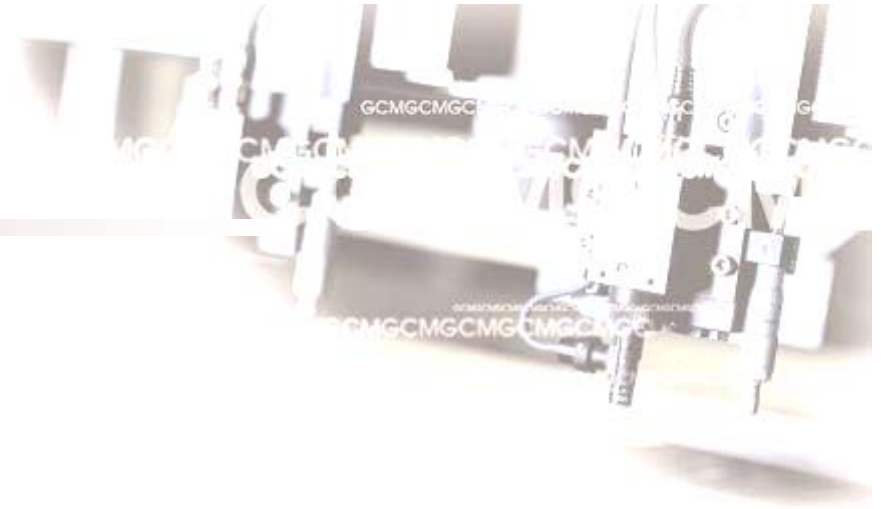
(百万円)

	2007年2月期 実績	2008年2月期 実績	増減	増減理由等
流動資産	7,928	8,188	260	・現金及び預金増加 +630 ・棚卸資産減少 Δ378
固定資産	8,064	7,809	Δ254	・減価償却等 Δ145 ・関係会社長期貸付金の回収 Δ52
資産合計	15,993	15,998	5	
流動負債	6,753	6,385	Δ368	・支払手形減少 Δ476 ・1年内返済予定長期借入金増加 +153
固定負債	2,379	2,132	Δ247	・長期借入金減少 Δ232
負債合計	9,133	8,517	Δ616	
株主資本 評価・換算差額等	6,701 158	7,340 141	638 Δ16	・別途(任意)積立金増加 +450 ・繰越利益剰余金増加 +188
純資産合計	6,860	7,481	621	
負債純資産合計	15,993	15,998	5	

# 海外売上高(連結)

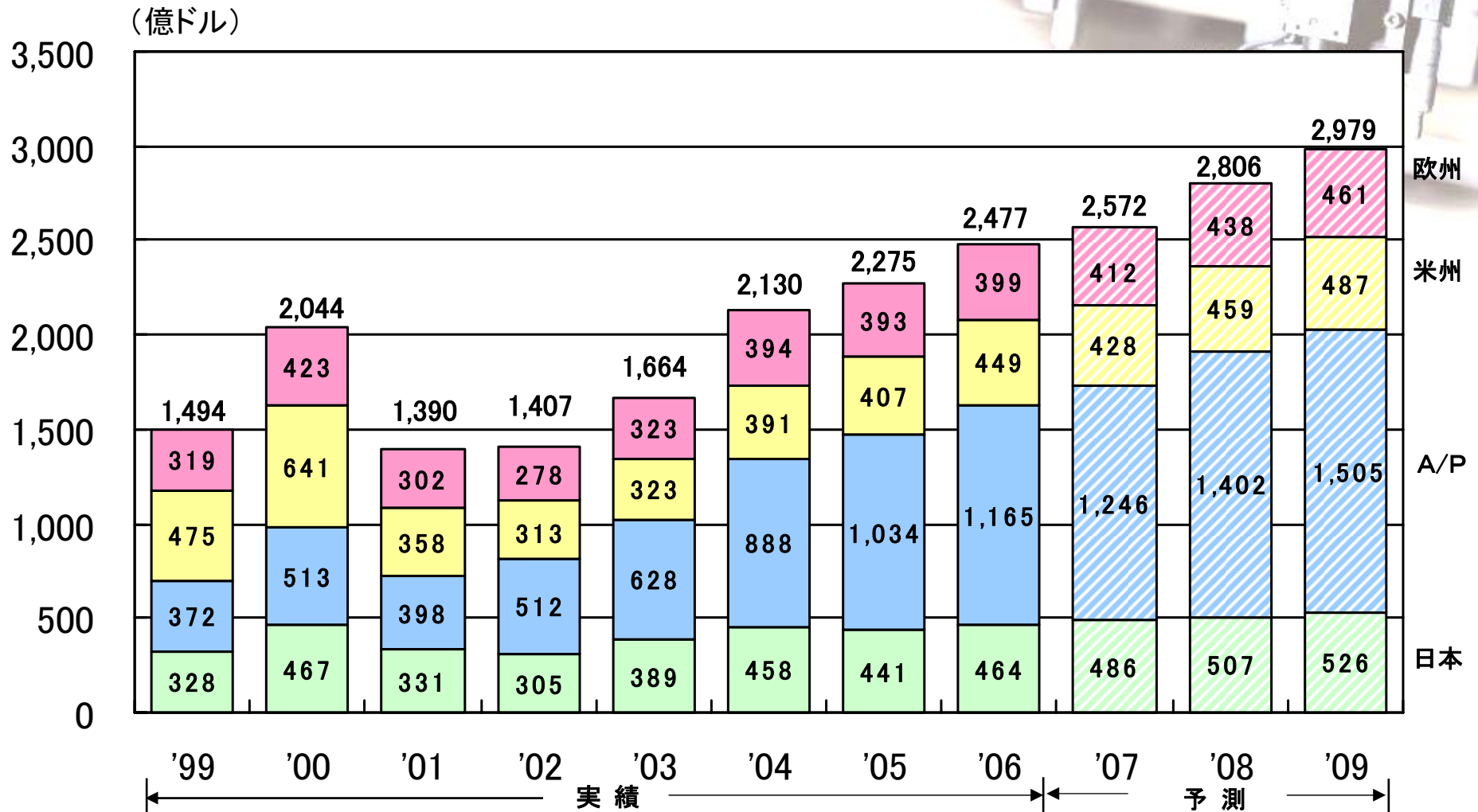






## 2009年2月期 業績予想

# 世界の地域別半導体市場規模

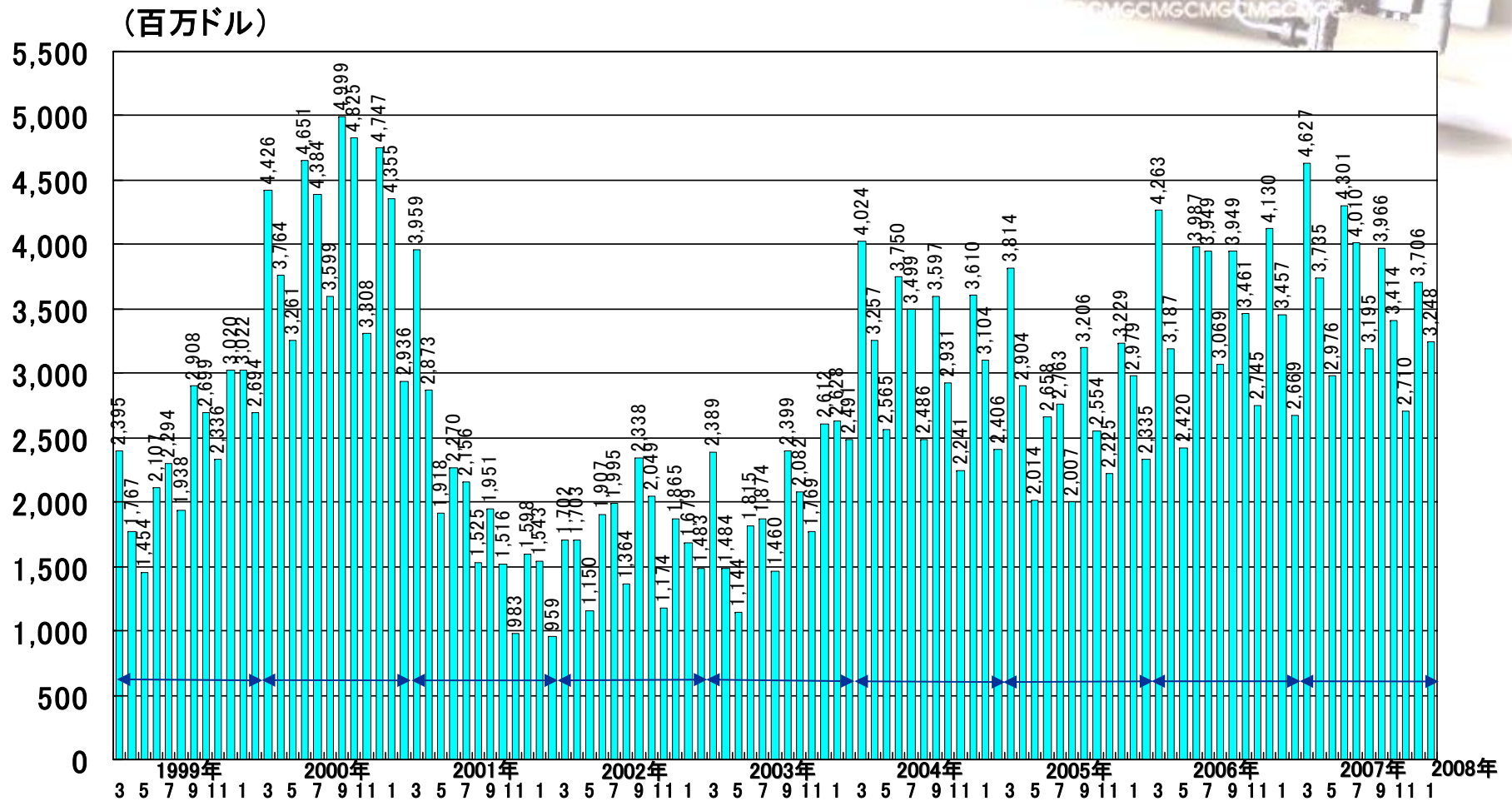


注:「A/P」はアジア・パシフィックの略

(出所:2007年11月28日付 半導体産業新聞) (2007年11月 WSTS発表)

# 世界規模 半導体製造装置販売統計

(2008年1月末現在)



(出所：SEA J, SEMI, SEMIジャパン)

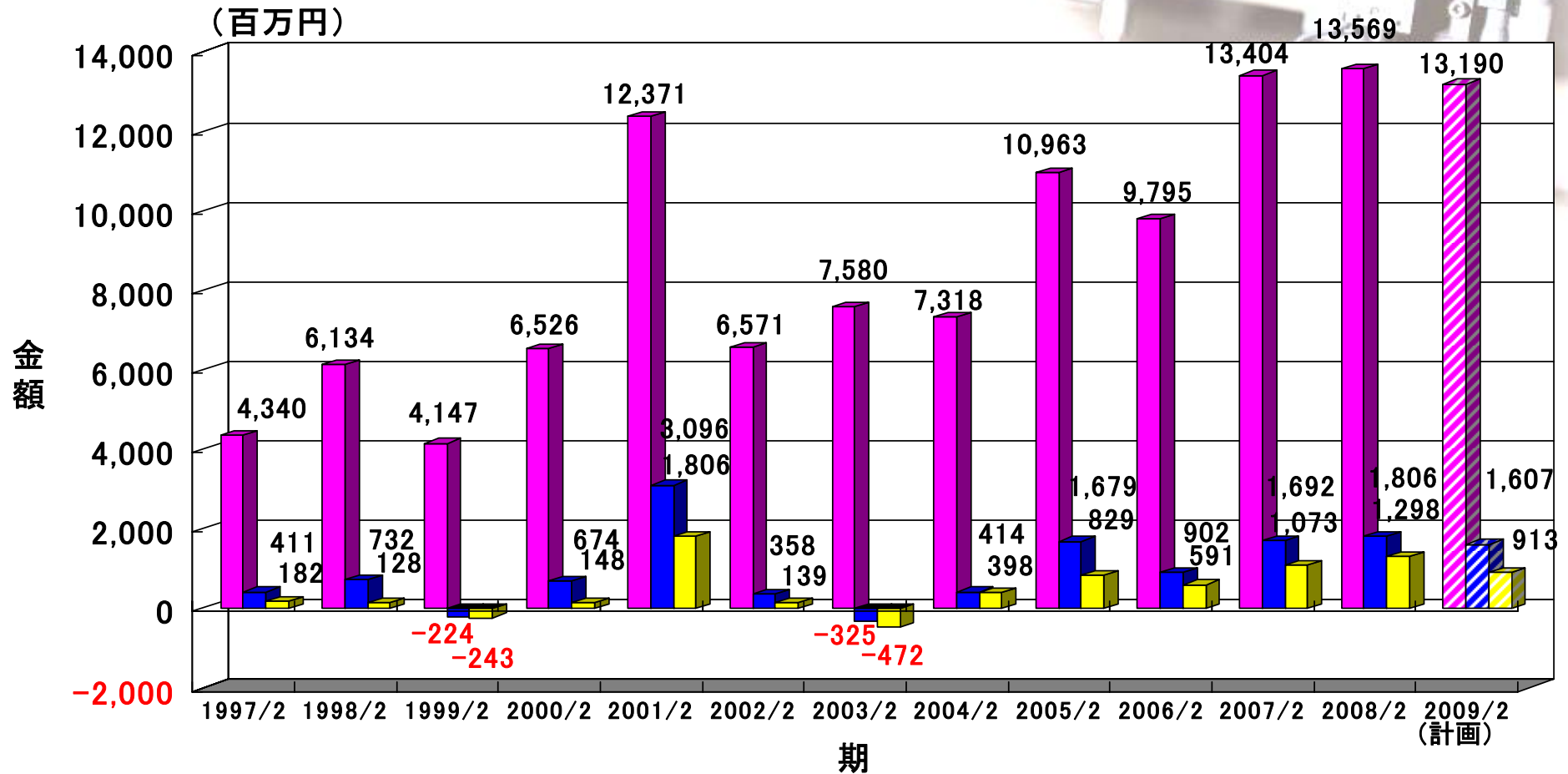
# 2009年2月期 連結業績予想

(百万円)

	2008年2月期 実績	2009年2月期 予想	前期比
売上高	13,569	13,190	97.2%
売上総利益	3,987	3,945	98.9%
販管費	2,157	2,230	103.3%
営業利益	1,829	1,714	93.7%
経常利益	1,806	1,607	89.0%
当期純利益	1,298	913	70.3%



# 連結業績の推移と今期計画

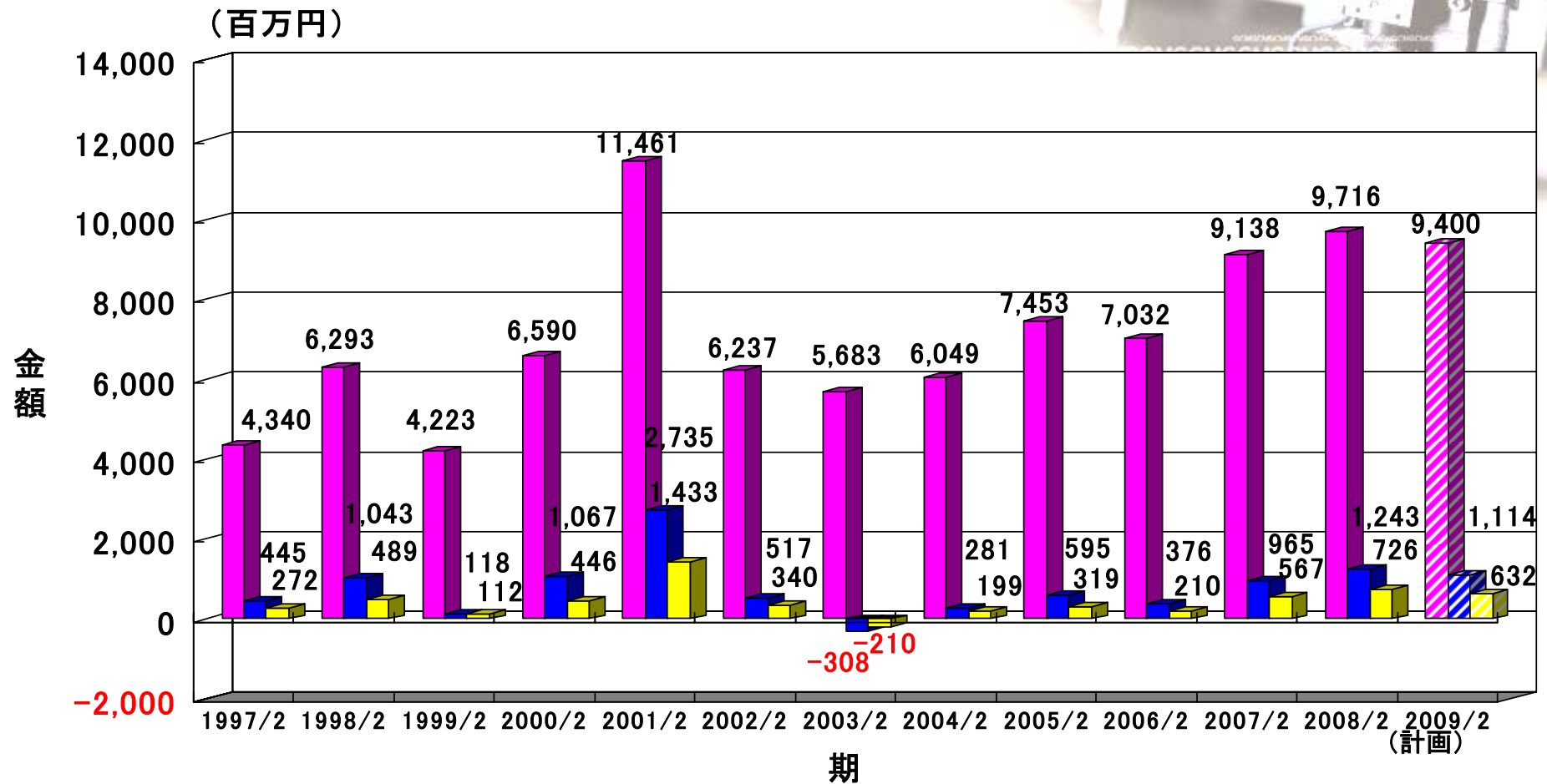


# 2009年2月期 単体業績予想

(百万円)

	2008年2月期 実績	2009年2月期 予想	前期比
売上高	9,716	9,400	96.7%
売上総利益	2,353	2,290	97.3%
販管費	1,076	1,074	99.8%
営業利益	1,277	1,216	95.2%
経常利益	1,243	1,114	89.6%
当期純利益	726	632	87.1%

# 単体業績の推移と今期計画



■ 売上高(実績)     
 ■ 経常損益(実績)     
 ■ 当期純損益(実績)

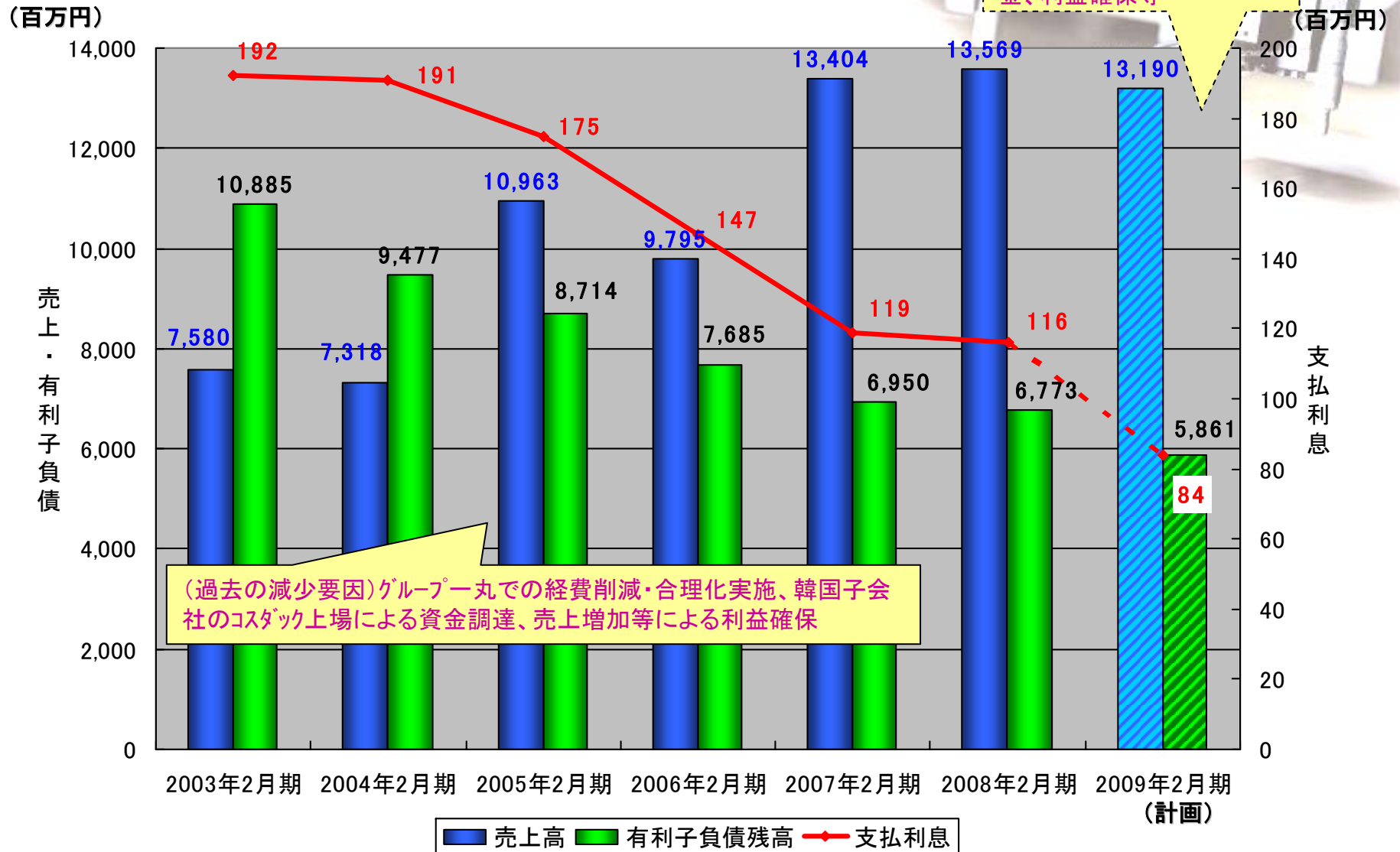
# ベトナム子会社設備増強



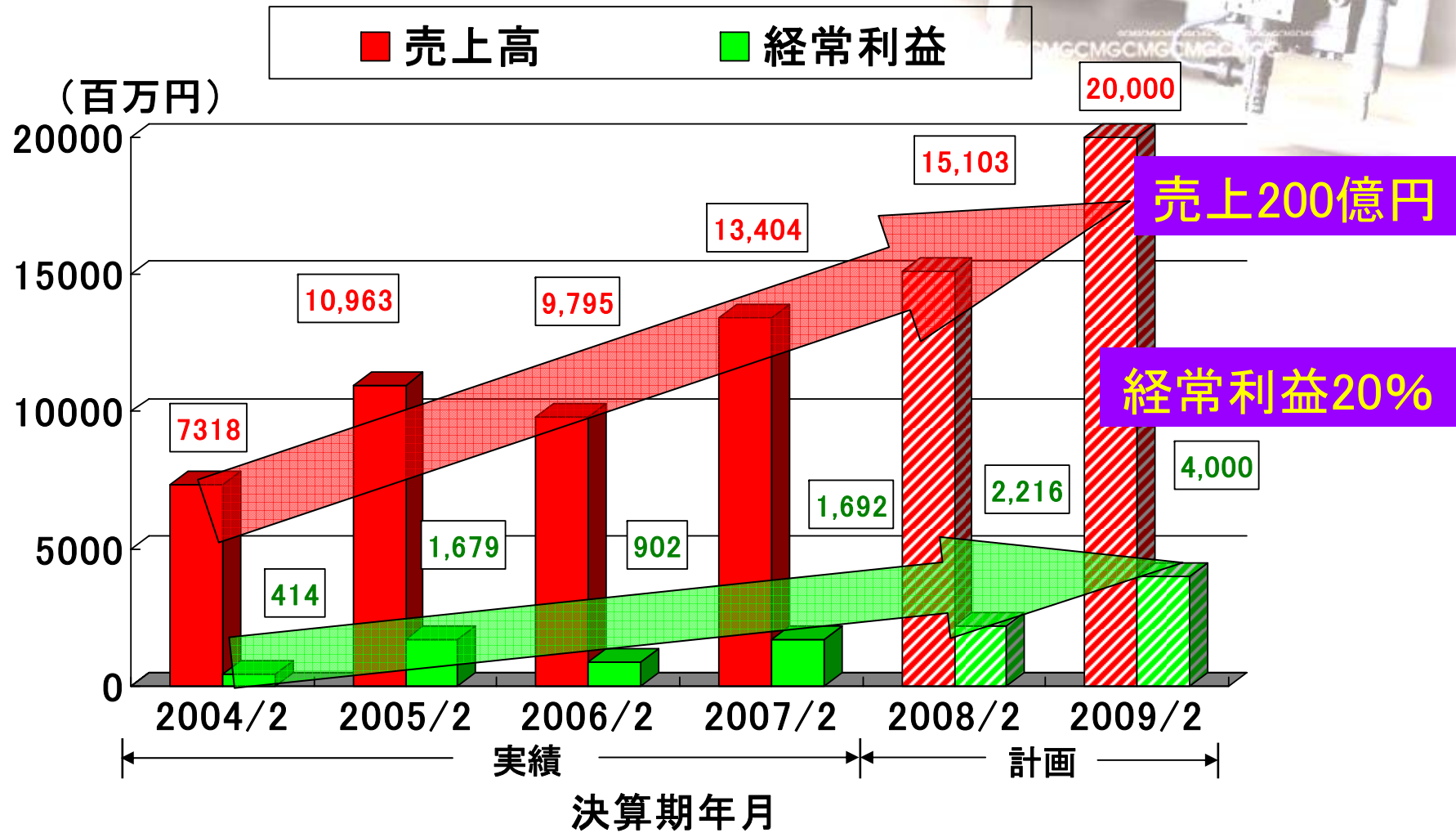


# 有利子負債残高の減少

(2009年2月期減少要因)  
韓国子会社旧工場売却代金、利益確保等

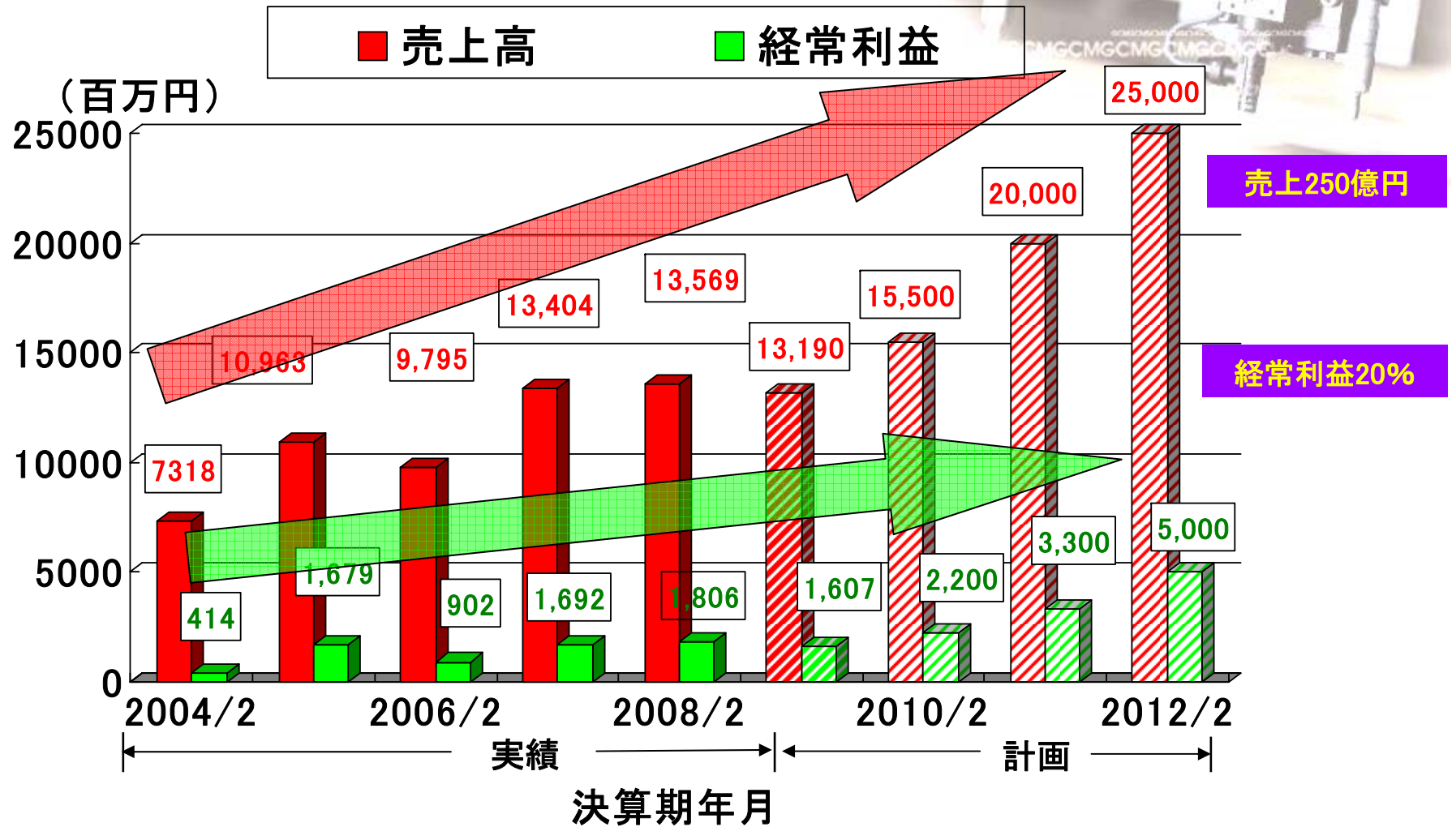


# チャレンジ5カ年計画



注. この資料は当社の現時点における期待、見積り及び予測に基づく目標であり、これら将来の事象、結果について何ら保証するものではありません。

# チャレンジ5カ年計画+3カ年



注. この資料は当社の現時点における期待、見積り及び予測に基づく目標であり、これら将来の事象、結果について何ら保証するものではありません。

# 本日はありがとうございました

## 注意事項

この資料は、決算の業績に関する情報及び将来についての計画や戦略、業績に関する予想及び見通しの記述が含まれております。

これらの記述は、当社が現時点で把握可能な情報から判断した見通しや予測であり、その情報の正確性、完全性を保証したり約束したりするものではありません。

また、経済動向や業界における競争、市場、諸制度等の変化により大きく見通しが変動する可能性があり、今後予告なしに変更されることがあります。